

トレックス・セミコンダクター株式会社
品質保証部

成分表

製品名(鉛フリー): XC6108xxxA/BGR-G
標準質量: 3 mg

名称	質量(mg)	物質名称	構成比率(ppm)	CAS No.
シリコンチップ	0.197	シリコン	65600	7440-21-3
		- 砒素	<1	7440-38-2
リードパッド	0.558	ニッケル	185900	7440-02-0
		銀	14900	7440-22-4
		金	2700	7440-57-5
ダイアタッチ	0.013	エポキシ樹脂	4300	—
		溶融シリカ	3300	60676-86-0
ボンディングワイヤ	0.059	金	19700	7440-57-5
封止樹脂	1.867	溶融シリカ	622200	60676-86-0
		結晶シリカ	14200	14808-60-7
		エポキシ樹脂	35300	—
		フェノール樹脂	21100	—
		金属水酸化物	10700	—

※ 成分組成は、ベンダーからの情報を元に算出しております。機密情報保持の為、開示されない情報があり、全内容を保証するものではありません。

※ 重量、構成比率については、材料等の製造条件によって異なることがあります。

※ CASNo.欄で「-」と表記された物質は、社外秘とさせていただきます。